

Podsumowanie zakończonej rundy finansowej

- 30 lipca 2020 roku spółka podjęła uchwałę o dokonaniu przydziału 48.648 obligacji imiennych serii A zamiennych na akcje serii U spółki, których cena emisyjna wynosiła 74 zł
- Łącznie objęte zostały obligacje w maksymalnej możliwej puli o wartości 3.599.952 zł
- Ogólnie z emisji akcji i obligacji spółka pozyskała 12.849.952 zł

NWZA w dniu 8 czerwca 2020 roku podjęło uchwałę w sprawie emisji akcji serii T oraz emisji obligacji zamiennych na akcje serii U. Wynikiem zakończonej rundy finansowej (emisji akcji i obligacji) jest pozyskanie 12,85 mln zł na dalszy rozwój spółki. 2 letnie obligacje zostały wyemitowane po cenie emisyjnej 74 zł i podlegają wykupowi w dniu 30 lipca 2022 roku. Oprocentowanie jest stałe i wynosi 2% w skali roku.

W czerwcu 2020 XTPL pozyskało 9,25 mln zł w wyniku przeprowadzonej emisji akcji, w której udział wzięli zarówno inwestorzy z Polski i zagranicy, a także CEO spółki dr Filip Granek. Łącznie spółka pozyskała 12,85 mln zł z emisji akcji i obligacji.

“Dziękujemy inwestorom za zaufanie, a zespołowi CC Group za wsparcie w procesie fundraisingowym.” - podkreśla Filip Granek.

Środki z emisji zostaną przeznaczone na rozwój prac R&D, kontynuację procesu komercjalizacji oraz poszerzenie portfolio w zakresie własności intelektualnej.

XTPL ma zabezpieczone środki na działalność badawczo-rozwojową do początku 2022, a pozyskane w wyniku rundy finansowej fundusze przybliżą spółkę do celu jakim jest powszechne stosowanie technologii XTPL w przemyśle.

XTPL to najbardziej precyzyjna technologia druku na świecie, mająca zastosowanie w szybko rosnącym rynku elektroniki. Metoda XTPL jest unikatowa ze względu na połączenie kilku cech: jest to metoda addytywna – pozwalająca na znaczne oszczędności czasu oraz materiału, umożliwiającą wykorzystanie zalet druku – takich jak skalowalność, efektywność kosztowa, prostota i szybkość – do produkcji zaawansowanych urządzeń dzięki niespotykanej dotąd precyzji (rozmiar struktur < 3 mikrometry) oraz bez konieczności użycia pola elektrycznego. Obecnie spółka koncentruje się na komercjalizacji technologii w dwóch polach aplikacyjnych. Pierwszym są wyświetlacze – tu XTPL zamierza najpierw zaoferować technologię naprawy defektów (ang. *open defect repair*) struktur przewodzących odpowiedzialnych między innymi za występowanie tzw. martwych pikseli, powstających w matrycach wysokorozdzielczych wyświetlaczy jeszcze na etapie produkcji. W kolejnych krokach spółka planuje dostarczyć tej branży rozwiązania umożliwiające znaczne podniesienie rozdzielczości nowej klasy wyświetlaczy oraz pozwalające na wytwarzanie wyświetlaczy na giętkich podłożach. Drugim potencjalnym polem aplikacyjnym dla XTPL jest rynek inteligentnego szkła (ang. *smart glass*). W dalszej perspektywie XTPL zamierza rozwijać swoje platformowe rozwiązanie dla kolejnych segmentów rynku. Technologia spółki może zostać wdrożona w branży półprzewodników, jako poszukiwana przez rynek alternatywa dla fotolitografii, a także m.in. ułatwić produkcję innowacyjnych zabezpieczeń antypodróbkowych, zaawansowanych płytek PCB, funkcjonalnych i efektywnych biosensorów, czy paneli fotowoltaicznych o zwiększonej wydajności. Postęp technologiczny, w którym istotną rolę ma odegrać XTPL, polega na umożliwieniu produkcji złożonych i skomplikowanych urządzeń elektronicznych za pomocą efektywnych kosztowo i skalowalnych metod druku. Więcej na xtpl.com.

KOMUNIKAT PRASOWY

Wrocław, 30/07/2020



shaping global nanofuture

Dodatkowych informacji udzielają:

Magdalena Żukowska | kierownik marketingu & komunikacji w XTPL S.A.

539 736 050 | magdalena.zukowska@xtpl.com